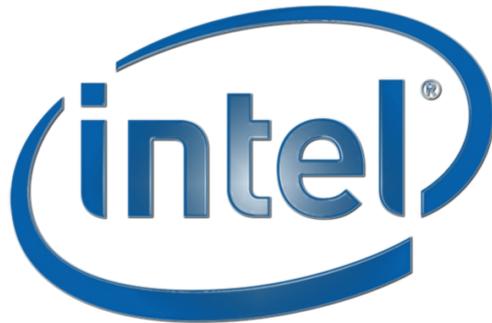


## Intel svela i nuovi Xeon Haswell-EP



**LINK (<https://www.nexthardware.com/news/processor-chipset/6374/intel-svela-i-nuovi-xeon-haswell-ep.htm>)**

Consumi più contenuti e sino a 18 core per i nuovi processori server e workstation del colosso di Santa Clara.



Intel ha finalmente presentato la lineup di Haswell-EP (Xeon E5-2600 V3), la nuova famiglia di CPU ad altissime prestazioni per server e workstation che va ad avvicinare Ivy Bridge-EP (Xeon E5-2600 V2)

uscito solo lo scorso anno.

## Intel® Xeon® E5-2600 v3 Platform Summary

The diagram illustrates the system architecture. At the top, an Intel Xeon processor E5-2600 v3 is connected to four DDR4 memory modules. Below it, another Intel Xeon processor E5-2600 v3 is connected to four more DDR4 modules. The two processors are connected via QPI 2 Channels. The second processor is connected to a LAN controller (Up to 4x10GbE) and a chipset. The chipset is connected to a LAN controller (Up to 4x10GbE). The processor is also connected to a PCIe 3.0, 40 lanes controller.

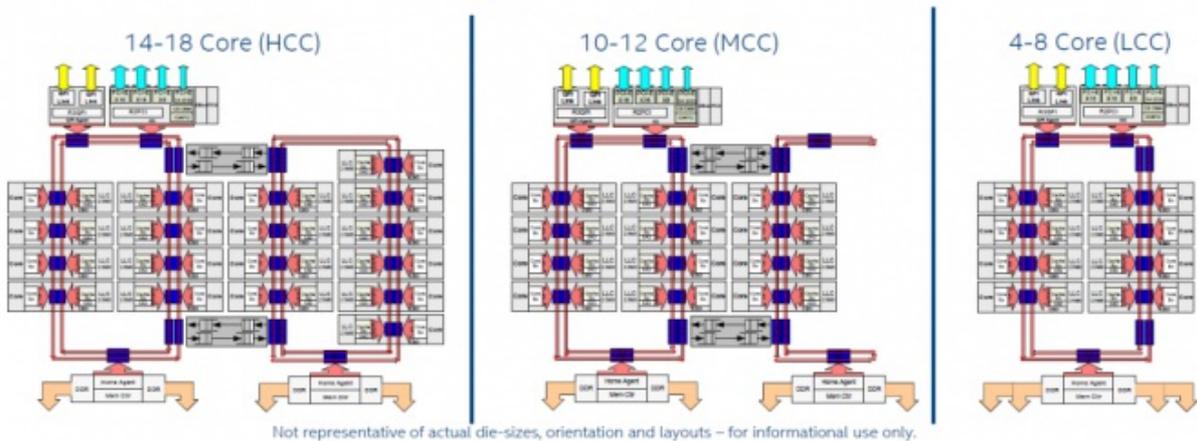
<b>CPU</b>	From 4 to 18 cores TDP: 55 W to 145 W (SVR); 160 W (WS)
<b>Socket</b>	Socket-R3
<b>Scalability</b>	2S capability
<b>Memory</b>	4xDDR4 channels 1333, 1600, 1866 (2 DPC), 2133 (1 DPC) RDIMM, LRDIMM
<b>QPI</b>	2xQPI 1.1 channels 6.4, 8.0, 9.6 GT/s
<b>PCIe*</b>	PCIe* 3.0 (2.5, 5, 8 GT/s) PCIe Extensions: Dual Cast, Atomics 40xPCIe* 3.0
<b>Intel® C612 Chipset</b>	DMI2 – 4 lanes; Up to 6xUSB3, 8x USB2 ports, 10xSATA3 ports; GbE MAC (+ External PHY)
<b>LAN</b>	40GbE - 1GbE
<b>Firmware</b>	Servers: Intel® Server Platform Services (SPS) Workstations: ME 9.x

*EP = Efficient Performance*  
Excellent balance of performance and power efficiency

Intel Confidential — Do Not Forward

Partendo con i dettagli architetturali, i processori Intel Haswell-EP Xeon E5-2600 V3 sono configurati in diverse varianti, che comprendono i modelli HCC (High Core Count), MCC (Medium Core Count) e LCC (Low Core Count).↔

## Haswell EP Die Configurations



Chop	Columns	Home Agents	Cores	Power (W)	Transistors (B)	Die Area (mm <sup>2</sup> )
HCC	4	2	14-18	110-145	5.69	662
MCC	3	2	6-12	65-160	3.84	492
LCC	2	1	4-8	55-140	2.60	354

Le versioni LCC vanno dai 4 agli 8 Core configurati su un Die da 354mm<sup>2</sup> composto da 2,6 miliardi di transistor, quelle MCC hanno dai 10 ai 12 Core integrati in un Die da 492mm<sup>2</sup> con 3,84 miliardi di transistor, mentre le HCC, ovvero i processori di punta, tra cui lo Xeon E5-2699 V3, offrono dai 15 ai 18 Core su un Die da 662mm<sup>2</sup> che racchiude 5,69 miliardi di transistor.

A titolo di confronto ricordiamo che la precedente CPU ammiraglia della famiglia Ivy Bridge-EX aveva 4,31

miliardi di transistor configurati su un Die da 541mm<sup>2</sup>.

Lo Xeon E5-2699 V3 rappresenta al momento la soluzione top di gamma e può vantare ben 18 Core, 36 Threads, 45MB di Cache L3, TDP da 145W e controller di memoria DDR4-2133MHz con un QPI (Quick Path Interconnect) da 9,6 GT/s per un costo finale di 4115 dollari.